### **Intel Pentium Dual Core**

#### **Elementos fundamentales**

Colección de productos Legacy Intel® Pentium® Processor

Nombre de código Products formerly Conroe

Segmento vertical Desktop

Número de procesador E2140

Litografía 65 nm

### Especificaciones de desempeño

Cantidad de núcleos 2

Frecuencia básica del procesador 1.60 GHz

Caché 1 MB L2 Cache

Velocidad del bus 800 MHz

Paridad FSB No

TDP 65 W

Rango de voltaje VID 0.8500V-1.5V

## Información complementaria

Estado Discontinued

Fecha de lanzamiento Q2'07

Opciones integradas disponibles No

# Especificaciones de paquete

Zócalos compatibles LGA775, PLGA775

TCASE L2=61.4°C; G0+M0=73.3°C

Tamaño de paquete 37.5mm x 37.5mm

Tamaño de chip de procesamiento 77 mm2

Cantidad de transistores de chip de procesador 105 million



#### Intel Celeron

#### **Elementos fundamentales**

Colección de productosLegacy Intel® Celeron® Processor

Nombre de códigoProducts formerly Tualatin

Segmento verticalDesktop

Litografía130

### Especificaciones de desempeño

Cantidad de núcleos1

Frecuencia básica del procesador1.10 GHz

Caché256 KB L2 Cache

Velocidad del bus100 MHz

Paridad FSBNo

**TDP28.9 W** 

Rango de voltaje VID1.475V

Información complementaria

Estado Discontinued

Opciones integradas disponiblesNo

Especificaciones de memoria

Extensiones de dirección física32-bit

Compatible con memoria ECC ‡No

Especificaciones de paquete

Zócalos compatiblesPPGA370

TCASE69°C

Tamaño de paquete49mm x 49mm

Tamaño de chip de procesamiento80 mm2

Cantidad de transistores de chip de procesador44 million



#### Intel Pentium 3

### **Elementos fundamentales**

Colección de productos Legacy Intel® Pentium® Processor

Nombre de código Products formerly Tualatin

Segmento vertical Desktop

Litografía 130 nm

# Especificaciones de desempeño

Cantidad de núcleos 1

Frecuencia básica del procesador 1.20 GHz

Caché 256 KB L2 Cache

Velocidad del bus 133 MHz

TDP 29.9 W

Rango de voltaje VID 1.5V

# Información complementaria

Estado Discontinued

Opciones integradas disponibles Yes

# Especificaciones de paquete

Zócalos compatibles PPGA370

TCASE 69°C

Tamaño de chip de procesamiento80 mm2

Cantidad de transistores de chip de procesador 44 million



#### **Intel Pentium**

#### **Elementos fundamentales**

Colección de productos Legacy Intel® Pentium® Processor

Nombre de código Products formerly Conroe

Segmento vertical Desktop

Número de procesador E2140

Litografía 65 nm

# Especificaciones de desempeño

Cantidad de núcleos 2

Frecuencia básica del procesador 1.60 GHz

Caché 1 MB L2 Cache

Velocidad del bus 800 MHz

Paridad FSB No

TDP 65 W

Rango de voltaje VID 0.8500V-1.5V

# Información complementaria

Estado Discontinued

Fecha de lanzamiento Q2'07

Opciones integradas disponibles No

# Especificaciones de paquete

Zócalos compatibles LGA775, PLGA775

TCASE L2=61.4°C; G0+M0=73.3°C

Tamaño de paquete 37.5mm x 37.5mm

Tamaño de chip de procesamiento 77 mm2

Cantidad de transistores de chip de procesador 105 million



#### Intel Xeon

#### **Elementos fundamentales**

Basados en la microarquitectura Raptor Cove.

Hasta 64 núcleos por procesador.

Tecnología de hiperprocesamiento (Hyper-Threading), permitiendo el doble de hilos de ejecución.

Soporte para memoria DDR5 (hasta 5600 MT/s).

Compatibilidad con memoria persistente Intel Optane.

Arquitectura de 8 canales de memoria.

Fabricados en proceso de 10 nm Enhanced SuperFin.

Tecnología Intel Speed Select para ajuste dinámico de rendimiento.

TDP entre 250W y 385W, dependiendo del modelo.

## Especificaciones de desempeño

## Frecuencia y Núcleos

Máximo de núcleos: 64

Máximo de hilos: 128 (con Hyper-Threading)

Frecuencia base: 1.9 GHz - 4.2 GHz (según el modelo)

Frecuencia Turbo: Hasta 4.3 GHz

### Memoria

Compatibilidad: DDR5 de hasta 5600 MT/s

Canales de memoria: 8

Capacidad máxima: 4 TB por procesador

Soporte para Intel Optane Persistent Memory

### Caché

Caché L2: 2 MB por núcleo

Caché L3: Hasta 320 MB (distribuido entre los núcleos)

Consumo Energético (TDP)Rango entre 250W y 385W, dependiendo del modelo y su configuración.

Modelos de alto rendimiento con refrigeración líquida pueden alcanzar mayores frecuencias con un TDP superior.



Felix arturo zuñiga saucedo

arquitectura de computadoras

Practica 2 reporte